

## 科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號  
聯絡人：潘敏治 副研究員  
電話：02-2737-7983  
傳真：02-2737-7673  
電子信箱：mcpa@most.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國106年9月7日  
發文字號：科部工字第1060070326號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：本部工程司推動107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，自即日起接受申請，請查照。

說明：

- 一、本計畫申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於106年11月20日(週一)前備函送達本部(請彙整造冊後專案函送，逾期恕不受理)。
- 二、本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值。
- 三、計畫之研究主題必須具有前瞻性、關鍵性及創新性，計畫內容必須陳述國內外現狀及所欲達成之技術指標，同時，必須陳述四年計畫規劃藍圖(roadmap)及執行內容，並具體說明階段性成果與後續產業化成效。
- 四、本部對執行計畫每年進行審查，執行團隊必須定期提報計畫執行進度與成果，並出席各項審查會議，各執行團隊須能展示該計畫所開發之技術或系統成果。



五、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：國立臺灣大學等303個機構

副本：本部綜合規劃司、工程技術研究發展司

2017-09-07  
11:00:27  
章

部長陳良基



裝

訂



08

線